

NEPCON JAPAN2024日本国际电子科技展览会--展期通知

产品名称	NEPCON JAPAN2024日本国际电子科技展览会--展期通知
公司名称	上海京硕展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	龙阳路2345号
联系电话	18939750396 18939750396

产品详情

2024日本国际电子科技展览会

NEPCON JAPAN

2024年09月04-06日（ 千葉 ）

2024 年 10 月 23-25 （ 名古屋 ）

2025年01月22-24日（ 东京 ）

展会规模：约1200家参展商； 参观人数：约50000名；

主办单位：励展博览集团日本株式会社

组展单位：上海贸升展览服务有限公司--日本展会服务商

展会介绍

作为“ 电子研发，制造与封装技术 ”的综合展会，NEPCON JAPAN随着日本及亚洲电子行业的发展不断成长壮大，至今已走过30多个年头。展会由电子产品制造设备及部件技术展，电子零部件检测设备及开发技术展，电子零部件封装设备及开发技术展，印刷电路展，电子元件及材料展，精密加工技术展这6个展会组成。是名副其实的“ 代表亚洲电子产业 ”的综合性展览会。NEPCON JAPAN作为了解“ 未来电子产业 ”的场所而备受业界瞩目，吸引越来越多来自全球的参展商与观展人士汇聚一堂！

市场介绍

日本是一个高度发达的资本主义国家。其资源匮乏并极端依赖进口，发达的制造业是国民经济的主要支柱。科研、航天、制造业、教育水平均居列。此外，以动漫、游戏产业为首的文化产业和发达的旅游也是其重要象征。据调查，日本在环境保护、资源利用等许多方面堪称世界，其国民普遍拥有良好的教育、极高的生活水平和国民素质。日本是电子工业强国，随着近年来人工智能电子工业的不断发展，日本本土的电子制造业呈现出衰退的趋势，由过去的销售快速增长到现在的依赖于电子核心部件、上游化学材料保有优势。在这个过程中，日本市场呈现出新的需求，为中国的整机产品、配套产品制造企业打入日本市场带来了良好的契机，同时也带来了广阔的合作机遇。据日本海关统计，2019年1月，日本与中国双边货物进出口额为764.0亿美元。其中，日本对中国出口340.5亿美元，总额增长14.2%；自中国进口423.5亿美元，总额增长7.0%。日本与中国的贸易逆差83亿美元。中国是日本第二大出口目的地。

构成展会

NEPCON JAPAN日本电子科技博览会由六大展会组成：

1、电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN

汇集了各种电子产品制造及SMT所用设备、解决方案、技术及服务。

2、电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：

亚洲的电子研发制造领域有关测试，检查，测量和分析技术的展会。

3、电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXP

亚洲的集成电路制造展！汇集了各种先进的设备、材料及服务。

4、电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO

亚洲！汇集各种电子元件和材料

5、印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo

装配设备、保证材料/组件、IC封装汇集了如PCB材料，设计开发委托服务与设计工具软件等各种PCBs/PWBs及技术。

6、精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO

电子制造领域精密加工技术专门展！诸如模具制造、切削、冲压加工、蚀刻等各种精密·微细加工技术汇聚一堂！

展览范围

电子产品制造设备及部件技术展 INTERNEPCON JAPAN：贴片机、点胶机、焊接设备/材料、封装设备、清洗设备、激光加工机、EMS/电子代工服务、清洁/静电防护器材、工厂/厂房设备

电子零部件检测设备及开发技术展ELECTROTEST JAPAN：各种检测设备、X射线检测设备、测试仪器、分离设备/软件、可靠性/评估检验设备、CCD相机、无损检测设备、合同分析服务

电子零部件封装设备及开发技术展 IC & Sensor Packaging TechnologyEXPO：装配设备、包装材料/组件、IC封装分析/模拟软件、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

电子元件及材料展ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALSEXPO：接线器、线缆、传感器、接线端子、电源开关、电阻器、转换器、电路安装材料、纳米技术材料

印刷电路展PWB EXPO – Printed Wiring Boards Expo：装配设备、保证材料/组件、IC封装分析/模拟软件、半导体器件/检测设备、SATS/契约设计服务、电镀/蚀刻材料及设备、MEMS设备/封装设备

精密加工技术展 FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO:冲压加工、切削/钻孔、精密/微细钣金加工、金属成型、电铸、精密铸造、镜面磨削、镭射加工、模塑、难切削材料加工

As a comprehensive exhibition of electronics R&D, Manufacturing and packaging technology, NEPCON JAPAN has been growing with the development of the electronics industry in Japan and Asia for more than 30 years. The exhibition consists of 6 exhibitions: electronic manufacturing equipment and components Technology exhibition, electronic parts testing equipment and development technology exhibition, electronic parts packaging equipment and development technology exhibition, printed circuit exhibition, electronic components and materials exhibition, precision machining technology exhibition. Is worthy of the name "on behalf of the Asian electronics industry" comprehensive exhibition. NEPCON JAPAN, as the place to learn about the "electronics industry of the future", is attracting more and more exhibitors and visitors from all over the world!